



**김종훈 TL**  
**SK hynix**

## Biography

### (1) 학력

2005년 한국과학기술원 재료공학과 공학박사

2000년 한국과학기술원 재료공학과 공학석사

1998년 국민대학교 금속재료공학과 공학사

### (2) 주요경력

2005~ 현재 : SK하이닉스 반도체 PKG 엔지니어

- SK하이닉스 SKHU 사내 전문강사 (2023~2025년)
- Chip Stackable FOWLP (VFO)기술 PoC 검증 (2019년)
- Hybrid Bonding HBM Stack W/S 검증 (2018년)
- CPB Flip Chip E/S 개발 (2010~2011년)
- TSV 요소기술 개발 (2007~2009년)